



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 5019.6—2007/IEC 60371-3-4:1992

---

## 以云母为基的绝缘材料 第 6 部分：聚酯薄膜补强 B 阶环氧树脂 粘合云母带

Specification for insulating materials based on mica—  
Part 6: Specification for individual materials—  
Polyester film-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder

(IEC 60371-3-4:1992, IDT)

2007-12-03 发布

2008-05-20 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
以云母为基的绝缘材料  
第 6 部分:聚酯薄膜补强 B 阶环氧树脂  
粘合云母带

GB/T 5019.6—2007/IEC 60371-3-4:1992

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2008 年 4 月第一版

\*

书号: 155066·1-30931

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68522006

## 前 言

GB/T 5019《以云母为基的绝缘材料》由下列部分组成：

- 第 1 部分：定义及一般要求；
- 第 2 部分：试验方法；
- 第 3 部分：换向器隔板和材料；
- 第 4 部分：云母纸；
- 第 5 部分：电热设备用云母板；
- 第 6 部分：聚酯薄膜补强 B 阶环氧树脂粘合云母带；
- .....

本部分为 GB/T 5019 的第 6 部分。

本部分等同采用 IEC 60371-3-4:1992《以云母为基的绝缘材料 第 3 部分：单项材料规范 第 4 篇：聚酯薄膜补强 B 阶环氧树脂粘合云母带》及 2006 第 1 次修正。

本部分将“规范性引用文件”中的部分国际标准(ISO、IEC)改为已等同或修改采用转化的国家标准；另外在文本编辑格式上略作修改。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC 51)归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分主要起草人：罗传勇。

本部分为首次制定。

# 以云母为基的绝缘材料

## 第 6 部分：聚酯薄膜补强 B 阶环氧树脂 粘合云母带

### 1 范围

本部分规定了由云母纸与单层聚酯薄膜复合并以环氧树脂浸渍云母纸而成的电气绝缘材料的性能要求。产品柔软状态供货,其所含的 B 阶树脂经使用后最终固化。供货方式可以是成张或成卷。

本部分所涉及的产品性能厚度为 0.16 mm~0.23 mm。

符合本部分的材料,满足一定的性能水平。然而,对于某一具体应用,应根据实际应用对材料所需要的具体性能要求来选择,而不是仅根据本部分来定。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 5019 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 1408.1—2006 绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分:工频下试验(IEC 60243-1:1998, IDT)

GB/T 12802.2—2004 电气绝缘用薄膜 第 2 部分:电气绝缘用聚酯薄膜(IEC 60371-3-2:1992, MOD)

IEC 60371-2:2004 以云母为基的绝缘材料 第 2 部分:试验方法

IEC 60371-3-2:2005 以云母为基的绝缘材料 第 4 部分:云母纸

### 3 命名

当按本部分订购产品时,可按表 1 报出型号。

例如: GB/T 5019.6—2007:6.01 型

型号按下列规定:

——标准部分编号 6

——加上产品编号 01

即型号为:6.01。

表 1 中“(组成)说明代号”,例如,对 6.01 型的 F23/M150/R54,含义如下:

——薄膜厚度(F)23  $\mu\text{m}$ ;

——白云母含量(M)150  $\text{g}/\text{m}^2$ ;

——树脂含量(R)54  $\text{g}/\text{m}^2$ 。

注:对于金云母纸,则把字母“M”换成“P”。